

Die Bonder 2100 xP von Oerlikon Esec zum innovativsten Schweizer Produkt gekürt

Oerlikon gewinnt Swiss Technology Award

Cham/Basel, 6. November 2008 – Die Innovationsstärke des Oerlikon Konzerns erfährt eine weitere Bestätigung: Der *Die Bonder 2100 xP* von Oerlikon Esec – eine Hochpräzisionsmaschine für die Chipmontage in der Halbleiterindustrie – wurde gestern Abend mit dem renommierten Swiss Technology Award zum innovativsten Schweizer Produkt des Jahres gekürt. Die vollkommen neu entwickelte Maschine ermöglicht gegenüber herkömmlichen Lösungen eine Produktivitätssteigerung um bis zu 80 Prozent. „Mit dem Die Bonder 2100 xP ist uns eine bahnbrechende Neuentwicklung gelungen, die in der Verarbeitung von Computerchips neue Massstäbe setzt in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit“, sagt Dr. Rainer Kyburz, Head of R&D Oerlikon Esec. Mit über 1500 Spezialisten und einem F&E-Umsatzanteil von rund fünf Prozent zählt Oerlikon zu den innovationsstärksten Unternehmen der Schweiz. „Der Swiss Technology Award ist eine eindrucksvolle Anerkennung unseres ständigen Strebens, die Grenzen des technisch Machbaren zu erweitern und damit zum Erfolg unserer Kunden beizutragen. Lob und Dank gebührt den Oerlikon-Forschern und -Entwicklern, die diesen Pioniergeist in ihrer täglichen Arbeit leben“, sagt Dr. Uwe Krüger, CEO des Oerlikon Konzerns.

Die Bonder spielen in der Herstellung von Halbleitern eine wichtige Rolle: Sie nehmen einzelne, ungeschützte Chips von einer Halbleiterscheibe (Wafer) auf und fixieren sie mittels Spezialkleber oder Lotmaterial auf dem Trägermaterial. Diesen Vorgang, „Pick & Place“ genannt, gilt es möglichst schnell und dabei hoch präzise auszuführen. Die Anforderungen in der Halbleiterindustrie bezüglich Effizienz und Qualität sind dabei extrem. Der neue Die Bonder 2100 xP von Oerlikon Esec ist in der Lage, innerhalb einer Sekunde vier Chips mit einer Genauigkeit von 5 tausendstel Millimeter zu platzieren – eine bisher in der Industrie unerreichte Spitzenleistung.

Ermöglicht wird diese Leistungsfähigkeit durch ein revolutionäres Maschinenlayout, das eine ganz neue Bewegung zulässt. Wurde das Pick- and Place bislang in einem dreigeteilten, eckigen Vorgang vollzogen – Chip aufnehmen, hochfahren, zum Träger übersetzen und ablegen – gelingt mit dem neuen Die Bonder jetzt erstmals eine

Seite 2 durchgehende, runde Bewegung. Diese Transformation der Bewegungsabläufe zu realisieren gilt als die hohe Kunst der Robotik. Gleichzeitig führen weitere Detailinnovationen dazu, nicht-produktive Standzeiten zu minimieren. Eine ebenfalls neuartige graphische Bedieneroberfläche ermöglicht die wesentlich einfachere und effizientere Handhabung der Maschine. 40 Spezialisten aus den Bereichen Robotik, Elektronik, Bilderkennung, Regelungstechnik, Software, Engineering und Product Management haben hierfür interdisziplinär zusammen gearbeitet. In Summe führt der Oerlikon Esec Die Bonder 2100 xP damit zu einer Produktivitätssteigerung um bis zu 80 Prozent. „Ein solcher Durchbruch galt als eigentlich unmöglich“, sagt Dr. André Richoz, Leiter der Geschäftseinheit Oerlikon Esec. „Wir sind stolz, mit neuen Ansätzen dies ermöglicht zu haben und danken dem Swiss Innovation Forum für die Auszeichnung“, so Richoz.

Der Swiss Technology Award ist der führende Technologie- und Innovationspreis der Schweiz, mit dem seit 1987 gezielt Innovationen gefördert werden. Während in den letzten Jahren Projekte der Biotechnologie das Rennen machten, dominierten 2008 wieder Innovationsbereiche mit traditionell schweizerischen Stärken: Robotik und Nanotechnologie für Fertigungsprozesse sowie die Computertechnologie. Eine hochkarätige Experten-Jury hat in einem zweistufigen Auswahlverfahren aus über 50 Bewerbungen sowohl die Innovationskraft wie auch das Marktpotenzial der Eigenentwicklung von Oerlikon Esec mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Die Bonder 2100 xP wurde offiziell im Mai 2008 an der Fachmesse SEMICON in Singapur im Markt eingeführt und fand sofort grossen Anklang.

Bildlegenden:

Bild 1: Die vollkommen neu entwickelte Maschine Die Bonder 2100 xP von Oerlikon Esec ermöglicht dank dem revolutionären Maschinenlayout gegenüber herkömmlichen Lösungen eine Produktivitätssteigerung um bis zu 80 Prozent.

Bild 2: Das rotative "Pick&Place"-Verfahren des neuen Die Bonder 2100 xP von Oerlikon Esec ermöglicht pro Sekunde vier Chip-Platzierungen mit einer Genauigkeit von 5 tausendstel Millimeter – eine hohe Kunst in der Robotik und eine bisher in der Industrie unerreichte Spitzenleistung.

Seite 3 Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Burkhard Böndel Corporate Communications Phone +41 58 360 96 02 Fax +41 58 360 91 93 pr@oerlikon.com www.oerlikon.com	Frank Heffter Corporate Investor Relations Phone +41 58 360 96 22 Fax +41 58 360 91 93 ir@oerlikon.com www.oerlikon.com
--	--

Über Oerlikon und Oerlikon Esec

Oerlikon Esec ist führender Anbieter von hochinnovativen Anlagen und Lösungen für die Halbleiter- und Mikrotechnologie-Industrie. Mit Innovationskraft und bestausgebildeten Experten trägt Oerlikon Esec zum kommerziellen Erfolg seiner Kunden bei. Zu den Hauptprodukten zählen Die Bonder (zur Befestigung der offenen, ungeschützten Halbleiter auf das Trägermaterial) und Wire Bonder (stellt die elektrischen Verbindungen zwischen Halbleiter und Anschlüssen auf dem Trägermaterial her).

Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cham. Oerlikon Esec beschäftigt weltweit rund 630 Mitarbeitende. In Singapur befindet sich die Zentrale für den südost-asiatischen Markt, dem grössten und wichtigsten Markt von Oerlikon Esec. Mit sieben Service Centers in Europa, in den USA und in asiatischen Schlüsselmärkten stellt das Unternehmen die Kundennähe und schnelle Reaktionszeiten sicher.

Oerlikon Esec ist ein Unternehmen von OC Oerlikon (SWX: OERL), das zu den weltweit erfolgreichsten Hightech-Industriekonzernen mit einem Fokus auf Maschinen- und Anlagenbau zählt. Das Unternehmen steht für führende Industrielösungen und Spitzentechnologien und ist in den sechs Segmenten Textilmaschinen- und Anlagenbau, Dünnschicht-Solar, Dünnschicht-Beschichtung, Antriebs-, Präzisions- und Vakuumtechnologie tätig. Als Unternehmen mit schweizerischem Ursprung und einer 100jährigen Tradition ist Oerlikon mit über 19'000 Mitarbeitenden an 170 Standorten in 35 Ländern heute ein Global Player und erwirtschaftete 2007 einen Umsatz von CHF 5,6 Mrd. Das Unternehmen ist in den jeweiligen Märkten an erster oder zweiter Position und investierte 2007 knapp 5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung (CHF 274 Mio.).